



# 中华人民共和国国家标准

GB/T 6346.1101—2015/IEC 60384-11-1:2008  
代替 GB/T 6347—1986

## 电子设备用固定电容器 第 11-1 部分：空白详细规范 金属箔式聚乙烯对苯二甲酸乙二醇酯膜 介质直流固定电容器 评定水平 EZ

Fixed capacitors for use in electronic equipment—Part 11-1: Blank detail specification—Fixed polyethylene-terephthalate film dielectric metal foil d.c. capacitors—Assessment level EZ

(IEC 60384-11-1:2008, IDT)

2015-07-03 发布

2016-03-01 实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局  
中国国家标准化管理委员会 发布

## 前 言

《电子设备用固定电容器》已经或计划发布的国家标准如下：

- 第 1 部分：总规范(GB/T 2693—2001/IEC 60384-1:1999)；
- 第 2 部分：分规范 金属化聚乙烯对苯二甲酸酯膜介质直流固定电容器(GB/T 7332—2011/IEC 60384-2:2005)；
- 第 2-1 部分：空白详细规范 金属化聚乙烯对苯二甲酸酯膜介质直流固定电容器 评定水平 E 和 EZ(GB/T 7333—2012/IEC 60384-2-1:2005)；
- 第 3 部分：分规范 表面安装 MnO<sub>2</sub> 固体电解质钽固定电容器(GB/T 6346.3—2015/IEC 60384-3:2006)；
- 第 3-1 部分：空白详细规范 表面安装 MnO<sub>2</sub> 固体电解质钽固定电容器 评定水平 EZ(GB/T 6346.301—2015/IEC 60384-3-1:2006)；
- 第 4 部分：分规范 固体和非固体电解质铝电容器(GB/T 5993—2003/IEC 60384-4:1998)；
- 第 4-1 部分：空白详细规范 非固体电解质铝电容器 评定水平 E(GB/T 5994—2003/IEC 60384-4-1:2000)；
- 第 6 部分：分规范 金属化聚碳酸酯膜介质直流固定电容器(GB/T 14004—1992/IEC 60384-6:1987)；
- 第 6-1 部分：空白详细规范 金属化聚碳酸酯膜介质直流固定电容器 评定水平 E(GB/T 14005—1992/IEC 60384-6-1:1987)；
- 第 7 部分：分规范 金属箔式聚苯乙烯膜介质直流固定电容器(GB/T 10185—2012)；
- 第 7-1 部分：空白详细规范 金属箔式聚苯乙烯膜介质直流固定电容器 评定水平 E(GB/T 10186—2012)；
- 第 8 部分：分规范 1 类瓷介固定电容器(GB/T 5966—2011/IEC 60384-8:2005)；
- 第 8-1 部分：空白详细规范 1 类瓷介固定电容器 评定水平 EZ(GB/T 5967—2011/IEC 60384-8-1:2005)；
- 第 9 部分：分规范 2 类瓷介固定电容器(GB/T 5968—2011/IEC 60384-9:2005)；
- 第 9-1 部分：空白详细规范 2 类瓷介固定电容器 评定水平 EZ(GB/T 5969—2012/IEC 60384-9-1:2005)；
- 第 11 部分：分规范 金属箔式聚乙烯对苯二甲酸乙二醇酯膜介质直流固定电容器(GB/T 6346.11—2015/IEC 60384-11:2008)；
- 第 11-1 部分：空白详细规范 金属箔式聚乙烯对苯二甲酸乙二醇酯膜介质直流固定电容器 评定水平 EZ(GB/T 6346.1101—2015/IEC 60384-11-1:2008)；
- 第 13 部分：分规范 金属箔式聚丙烯膜介质直流固定电容器(GB/T 10188—2013/IEC 60384-13:2006)；
- 第 13-1 部分：空白详细规范 金属箔式聚丙烯膜介质直流固定电容器 评定水平 E 和 EZ(GB/T 10189—2013/IEC 60384-13-1:2006)；
- 第 14 部分：分规范 抑制电源电磁干扰用固定电容器(GB/T 6346.14—2015/IEC 60384-14:2005)；
- 第 14-1 部分：空白详细规范 抑制电源电磁干扰用固定电容器 评定水平 D(GB/T 6346.1401—2015/IEC 60384-14-1:2005)；

- 第 15 部分:分规范 非固体或固体电解质钽电容器(GB/T 7213—2003/IEC 60384-15:1982, 第 1 号修改单:1987,第 2 号修改单:1992);
- 第 15-1 部分:空白详细规范 非固体电解质箔电极钽电容器 评定水平 E(GB/T 12794—1991/IEC 60384-15-1:1984);
- 第 15-2 部分:空白详细规范 非固体电解质多孔阳极钽电容器 评定水平 E(GB/T 12795—1991/IEC 60384-15-2:1984);
- 第 15-3 部分:空白详细规范 固体电解质和多孔阳极钽电容器 评定水平 E(GB/T 7214—2003/IEC 60384-15-3:1992);
- 第 16 部分:分规范 金属化聚丙烯膜介质直流固定电容器(GB/T 10190—2012/IEC 60384-16:2005);
- 第 16-1 部分:空白详细规范 金属化聚丙烯膜介质直流固定电容器 评定水平 E 和 EZ (GB/T 10191—2011/IEC 60384-16-1:2005);
- 第 17 部分:分规范 金属化聚丙烯膜介质交流和脉冲固定电容器(GB/T 14579—2013/IEC 60384-17:2005);
- 第 17-1 部分:空白详细规范 金属化聚丙烯膜介质交流和脉冲固定电容器 评定水平 EZ (GB/T 14580—2013/IEC 60384-17-1:2005);
- 第 18 部分:分规范 固体(MnO<sub>2</sub>)与非固体电解质片式铝固定电容器(GB/T 17206—1998/IEC 60384-18:1993,第 1 号修改单:1998);
- 第 18-1 部分:空白详细规范 表面安装固体(MnO<sub>2</sub>)电解质铝固定电容器 评定水平 EZ (GB/T 17207—2012/IEC 60384-18-1:2007);
- 第 18-2 部分:空白详细规范 非固体电解质片式铝固定电容器 评定水平 E(GB/T 17208—1998/IEC 60384-18-2:1993);
- 第 19 部分:分规范 表面安装金属化聚乙烯对苯二甲酸酯膜介质直流固定电容器 (GB/T 15448—2013/IEC 60384-19:2005);
- 第 19-1 部分:空白详细规范 表面安装金属化聚乙烯对苯二甲酸酯膜介质直流固定电容器 评定水平 EZ (GB/T 16467—2013/IEC 60384-19-1:2005);
- 第 21 部分:分规范 表面安装用 1 类多层瓷介固定电容器(GB/T 21041—2007/IEC 60384-21:2004);
- 第 21-1 部分:空白详细规范 表面安装用 1 类多层瓷介固定电容器 评定水平 EZ (GB/T 21038—2007/IEC 60384-21-1:2004);
- 第 22 部分:分规范 表面安装用 2 类多层瓷介固定电容器(GB/T 21042—2007/IEC 60384-22:2004);
- 第 22-1 部分:空白详细规范 表面安装用 2 类多层瓷介固定电容器 评定水平 EZ (GB/T 21040—2007/IEC 60384-22-1:2004)。

本部分为《电子设备用固定电容器》的第 11-1 部分。

本部分按照 GB/T 1.1—2009 和 GB/T 20000.2—2009 给出的规则起草。

本部分代替 GB/T 6347—1986《电子设备用固定电容器 第 11 部分:空白详细规范 金属箔式聚乙烯对苯二甲酸乙二醇酯膜介质直流固定电容器 评定水平 E(可供认证用)》。

本部分与 GB/T 6347—1986 相比,主要技术变化如下:

- 耐久性试验时间由 2 000 h 改为 1 000 h;
- 增加 4.13 元件耐溶剂和 4.14 标志耐溶剂试验项目(见 4.13、4.14);
- 评定水平由 E 改为 EZ;
- 鉴定批准试验的样品数由原规定“4 种值各 29 只和备份各 2 只、6 种值各 29 只和备份各 2 只”

改为“固定样品 108 只和 12 只备份”，允许不合格品数由原规定“4 种值允许 4 只、6 种值允许 6 只”改为 0 只；

——逐批检验增加 A0 组，检验水平(IL)由 A1 组 S-4、A2 组 II、B1 组 S-3 改为 A0 组 100%、其他组均为 S-3；合格质量水平(AQL%)由 A1 组 2.5、A2 组 1.0、B1 组 2.5 改为零失效；

——周期检验的周期：C3 组由 3 个月改为 6 个月，C4 组由 12 个月改为 6 个月；

样品数：C1A 组由 9 只改为 5 只，C1B 组由 18 只改为 5 只，C1 组由 27 只改为 10 只，

C2 组由 15 只改为 10 只，C3 组由 21 只改为 10 只，C4 组由 9 只改为 10 只；

允许不合格品数：C1A 和 C1B 组各 1 只改为 0 只，C1 组由 2 只改为 0 只，C2、C3、C4 组由各 1 只改为 0 只；

——规范名称由“第 11 部分”改为“第 11-1 部分”。

本部分使用翻译法等同采用 IEC 60384-11-1:2008《电子设备用固定电容器 第 11-1 部分：空白详细规范 金属箔式聚乙烯对苯二甲酸乙二醇酯膜介质直流固定电容器 评定水平 EZ》，为了便于使用，对 IEC 60384-11-1:2008 还进行了编辑性修改，具体修改如下：

——删除了 IEC 前言，增加 GB 前言；

——IEC 第 2 页注 2 改为注 1；

——IEC 60068 的无日期引用改为注日期引用。

本部分由中华人民共和国工业和信息化部提出。

本部分由全国电子设备用阻容元件标准化技术委员会(SAC/TC 165)归口。

本部分起草单位：国营第七一五厂。

本部分主要起草人：王珏、董小婕。

本部分所代替标准的历次版本发布情况为：

——GB/T 6347—1986。

**电子设备用固定电容器**  
**第 11-1 部分:空白详细规范**  
**金属箔式聚乙烯对苯二甲酸乙二醇酯膜**  
**介质直流固定电容器 评定水平 EZ**

**空白详细规范**

空白详细规范是分规范的一种补充性文件,它包括对详细规范的格式、编排和最少内容的要求。不遵守这些要求的详细规范,认为是不符合电子元件质量评定体系要求的规范。

制定详细规范时,应考虑分规范 1.4 的内容。

首页括号内数字标注的位置上应填写下列相应内容:

**详细规范的识别**

- [1] 授权起草本详细规范的组织:IEC 或国家标准机构。
- [2] IEC 或国家标准的详细规范编号、发布日期以及国家标准体系需要的其他内容。
- [3] IEC 或国家标准的总规范编号及其版本号。
- [4] IEC 或国家标准的空白详细规范编号。

**电容器的识别**

- [5] 该型号电容器的简述。
- [6] 典型结构的简述(适用时)。

**注:**当电容器不是设计用于印制电路板时,在详细规范的这个位置上应该明确地加以说明。

- [7] 对影响互换性的主要尺寸的外形图和/或引用国家或国际的外形方面的文件。或者也可以在详细规范附录中给出这种图形。
- [8] 应用或涉及的应用组别和/或评定水平。

**注:**详细规范中采用的一个或几个评定水平,应从分规范 GB/T 6346.11—2015 中 3.5.4 中选取。这意味着只要试验组的划分不变,几个评定水平可以共用一个空白详细规范。

- [9] 重要性的参考数据,以便在各种类型电容器之间进行比较。